



LINTEC Advanced Technologies(Taiwan), Inc K.E.P.Z. BRANCH

No.6, Chung 6th Rd, K.E.P.Z, Kaohsiung Taiwan 806, R.O.C.

TEL: 886-7-8117000

FAX: 886-7-8117900

<b>Product name</b>	<b>RAD-3600F/12 (300mm 全自動晶圓 LC 膠帶貼合機)</b> <b>300mm Fully Automatic Wafer LC Tape Laminator</b> (用來做 Flip chip 封裝用的晶片背面保護膠帶「LC 膠帶」與晶圓的貼合)
<b>Power supply</b>	200~230VAC, 50/60HZ
<b>Air pressure</b>	0.5 to 0.8MPa
<b>Air consumption</b>	150 L/min (ANR) or less
<b>Vacuum supply</b>	-80kPa or higher
<b>Machine size/weight</b>	1550mm(W) x 1950mm(D) x 1800mm (H) (excluding the signal tower) Weight: 1600kg
<b>Processing capacity</b>	200mm Wafer->Max.32 wafers/hour(UPH) 300mm Wafer->Max.30 wafers/hour(UPH)



#### LC 膠帶專用貼膠機

將 Flip chip 封裝用的晶片背面保護膠帶「LC 膠帶」的特性發揮到最大，是對以往的「RAD-3500F/8DBS」的機台設計做改進後的新機型，並增加 300mm 晶圓的對應。

#### 高精確度的貼膠方式

使用獨自開發的貼附機構，實現無氣泡混入的高品質貼膠。

#### 機台內建 Pre-cut 機構

LC 膠帶外周的裁切以機台內建 Pre-cut 機構來進行，故對於已研磨晶圓的邊緣部分不會有刀片接觸的傷害。